



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20081001002A
2010 年 7 月 1 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタムドキュメント
マネージャ 牧 達郎 (牧)

TMS320C641xTB/TMS320TCI100B GLZ/ZLZパッケージ一部製品 バンプサイト追加のご案内
(捺印説明追加の連絡)

(第二版 PCN20081001002 2009 年 2 月 26 日発行, 初版 PCN20081001002 2008 年 12 月 24 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice
変更概要	Design/Specification	☐ Design ☐ Electrical ☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	☒ Wafer Bump	☒ Site ☐ Process ☐ Material
	Assembly	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	☐ Test	☐ Site ☐ Process
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling ☐ -
変更内容	下記変更について捺印説明追加の連絡になります。 TMS320C641xTB/TMS320TCI100B GLZ/ZLZ パッケージ 一部製品バンプサイト追加 現行：認定済みサイト 変更後：認定済みサイト及び Amkor T3 社 (台湾)	
対象製品	対象製品リスト参照	
変更時期	2009 年 4 月上旬の出荷より実施しています。	
品質認定試験	☐ 計画	☒ 終了
製品表示	☐ 変更無し	☒ 変更あり
備考	-	

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容：今回のお知らせは、下記変更について捺印説明追加の連絡になります。
 弊社 ASP (アプリケーションスペシフィックプロダクト) TMS320C641xTB / TMS320TCI100B (Rev 2.0) GLZ/ZLZ パッケージ一部製品について、現行認定済みバンブサイトに加えて、Amkor T3 社 (台湾) のバンブサイトを追加し認定しました。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差)、外觀、動作特性、品質、信頼性への影響はありません。

変更内容
バンブサイト

現行
認定済みサイト

変更後
認定済みサイト
Amkor T3 社 (台湾)

理由：バンブサイト追加の為

対象製品リスト

対象製品名				
TMS320C6414TBGLZ1	TMS320C6414TUGLZA8	TMS320C6415TUGLZ1	TMS320C6416TUZLZ7	TMS320TCI100UQLZ
TMS320C6414TBGLZ6	TMS320C6414TUGLZW6	TMS320C6415TUGLZ6	TMS320C6416TUZLZA7	TMS320TCI100UQLZR
TMS320C6414TBGLZ6M	TMS320C6414TUGLZW7	TMS320C6415TUGLZ7	TMS320C6416TUZLZW6	TMS320TCI100UQLZ6
TMS320C6414TBGLZ7	TMS320C6414TUZLZ1	TMS320C6415TUGLZ8	TMS320EDGEGELZ	TMS320TCI100UQLZ6N
TMS320C6414TBGLZ8	TMS320C6414TUZLZ6	TMS320C6415TUGLZW6	TMS320EDGEGUGLZ	TMS320TCI100UQLZ7
TMS320C6414TBGLZA6	TMS320C6414TUZLZ7	TMS320C6415TUGLZW7	TMS320TCI100BCLZ7	TMS320TCI100UQLZA6
TMS320C6414TBGLZA7	TMS320C6414TUZLZ8	TMS320C6415TUGLZW8	TMS320TCI100BGLZ6	TMS320TCI100UQLZA7
TMS320C6414TBGLZA8	TMS320C6414TUZLZA6	TMS320C6415TUZLZ1	TMS320TCI100BGLZ7	TMS320C6414TBGLZWA7
TMS320C6414TBGLZW6	TMS320C6414TUZLZA7	TMS320C6415TUZLZ6	TMS320TCI100BGLZA7	TMS320C6414TBGLZWA8
TMS320C6414TBGLZW7	TMS320C6414TUZLZW6	TMS320C6415TUZLZ7	TMS320TCI100BQCLZA	TMS320C6414TBZLZWA6
TMS320C6414TBGLZW8	TMS320C6414TUZLZW8	TMS320C6415TUZLZW6	TMS320TCI100BQGLZ	TMS320C6414TBZLZWA7
TMS320C6414TBZLZ1	TMS320C6415TBGLZ1	TMS320C6415TUZLZW7	TMS320TCI100BQGLZA	TMS320C6414TBZLZWA8
TMS320C6414TBZLZ6	TMS320C6415TBGLZ6	TMS320C6416TBGLZ1	TMS320TCI100BQZLZ	TMS320C6414TUGLZWA8
TMS320C6414TBZLZ7	TMS320C6415TBGLZ7	TMS320C6416TBGLZ6	TMS320TCI100BQZLZA	TMS320C6414TUZLZWA6
TMS320C6414TBZLZ8	TMS320C6415TBGLZA8	TMS320C6416TBGLZ7	TMS320TCI100BQZLZR	TMS320C6414TUZLZWA7
TMS320C6414TBZLZA6	TMS320C6415TBGLZW6	TMS320C6416TBGLZA6	TMS320TCI100BZLZ6	TMS320C6415TBZLZW7F
TMS320C6414TBZLZA7	TMS320C6415TBGLZW7	TMS320C6416TBGLZA8	TMS320TCI100BZLZ6N	TMS320C6416TBZLZWA7
TMS320C6414TBZLZA8	TMS320C6415TBGLZW8	TMS320C6416TBZLZ1	TMS320TCI100BZLZ7	TMS320C6416TUZLZWA7
TMS320C6414TBZLZW6	TMS320C6415TBZLZ1	TMS320C6416TBZLZ7	TMS320TCI100BZLZA6	TMX320TCI100BZLZ6N
TMS320C6414TBZLZW7	TMS320C6415TBZLZ6	TMS320C6416TBZLZA7	TMS320TCI100BZLZA7	TMX320TCI100BZLZ7
TMS320C6414TBZLZW8	TMS320C6415TBZLZ7	TMS320C6416TBZLZD1	TMS320TCI100UCLZ7	TMX320TCI100BZLZA7
TMS320C6414TUGLZ1	TMS320C6415TBZLZA6	TMS320C6416TBZLZW6	TMS320TCI100UGLZ6	
TMS320C6414TUGLZ6	TMS320C6415TBZLZA8	TMS320C6416TUGLZ1	TMS320TCI100UGLZ7	
TMS320C6414TUGLZ7	TMS320C6415TBZLZW6	TMS320C6416TUGLZ7	TMS320TCI100UQLZ	
TMS320C6414TUGLZ8	TMS320C6415TBZLZW7	TMS320C6416TUZLZ6	TMS320TCI100UQLZA	

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	2008 年 11 月 1 日	終了	2009 年 1 月 31 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Device: TMS320C641xTB / TMS320TCI100B				
Wafer Fab:	UMC12A		Assembly Site:	TI Philippines
Package/Code/Pins:	FCBGA / GLZ, ZLZ / 532		Package Lid:	Al Black Anodized
Package Substrate:	2/2/2 FCBGA		Moisture Sensitivity:	JEDEC L-4/260C
信頼性試験結果				
Reliability Test		Condition / Duration		Sample Size/ Fails
Storage Life		150C, 600hrs		130/0
**Temp. Cycle		-40/125C, 1000 cyc		385/0
**Unbiased HAST		110C/85% RH, 264 hrs		130/0
**Biased Humidity		85C/85% RH , Vddmax, 600 hrs		78/0
Manufacturability Qualification		Per TIPI mfg. specification		Approved
Board Level Reliability Temp Cycle		-40/125C, 1000 cyc, Virgin		32/0
		-40/125C, 1000 cyc, Rework		12/0
Note: ** Preconditioning required, JEDEC L-4/260C				

製品表示

今回の変更に伴い、製品捺印が下記の様になります。



CC = Core Clock Rate
 6: 1.1V/600MHz Standard temp
 A6: 1.1V/600MHz Extended temp
 "blank": 1.2V/720MHz Standard temp
 A7: 1.2V/720MHz Extended temp
 8: 1.2V/850MHz Standard temp
 A8: 1.2V/850MHz Extended temp
 ## = Wafer Fab Code
 D: KFAB
 \$N: UMC12A
 && = Die PG Revision
 10: initial
 20: final
 LLLL = Lot Trace Code
 S = Assembly Site Code
 W: TI-Philippines
 B = Bump Site Code
 A: Amkor
 D: TI-Dbump
 V = Substrate Vendor Code
 4: Ividen
 5: NTK
 A = Substrate Metal Layer
 2: 6ML
 o = Pin 1

図1 捺印表示の例